证券代码:301348 证券简称:蓝箭电子 公告编号:2025-008

佛山市蓝箭电子股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝箭电子	股票代码	301348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国光	林品旺	
办公地址	中国广东省佛山市禅城区古新路45号	中国广东省佛山市禅城区古新路45号	
传真	0757-63313400	0757-63313400	
电话	0757-63313388	0757-63313388	
电子信箱	zhangguoguang@fsbrec.com	linpinwang@fsbrec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1、报告期内公司所处行业情况

(1)所处行业

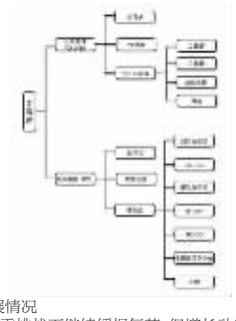
公司主营业务为半导体封装测试业务。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业下的电子器件制造业(行业代码:C397)。

(2)行业基本情况

①半导体行业概况

半导体是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。半导体产品主要应用于计算机、家用电器、数码电子、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多领域,全球半导体行业具有一定的周期性,景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。近年来,半导体应用领域随着科技进步不断延展,5G、物联网、人工智能、智能驾驶、云计算和大数据、机器人和无人机等新兴领域蓬勃发展,为半导体产业带来新的机遇。

按照产品分类,半导体可以分为分立器件和集成电路两大类。分立器件是指具有单独功能的电子元件,主要功能为实现各类电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等,具有广泛的应用范围和不可替代性。集成电路是指将一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路从功能、结构角度主要分为数字集成电路、模拟集成电路与数/模混合集成电路三类。

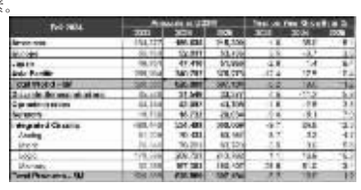


②全球半导体市场发展情况

2024年,全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏,但增长动能不足。主要央行走向货币宽松,纷纷开始进入降息周期。但地缘政治风险、贸易保护主义和供应链重构等问题仍对经济增长构成重大影响?。

对于半导体行业而言,2024年随着人工智能、AI等科学技术的不断升级、普及和发展,下游应用需求持续增长,推动半导体市场规模不断扩大。

世界半导体贸易统计协会(WSTS)相关数据显示,2024年第四季度全球半导体市场为1,709亿美元,同比增长17%,较2024年第三季度环比增长3%。2024年全年市场规模为6,280亿美元,比2023年增长19.1%。其中增长幅度最大的是存储芯片(增长81%)和算力芯片(增长16.9%)。展望2025年,WSTS预测半导体市场整体仍将保持增长,增长幅度约为11.2%,全球市场规模预计达到6,970亿美元。其中,算力芯片和存储芯片将继续成为增长的主要驱动因素。

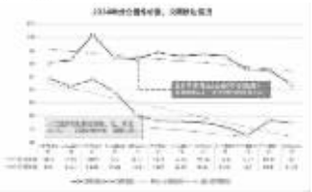


数据来源:WSTS

③分立器件行业概况

半导体分立器件是半导体产业的基础及核心领域之一,其具有应用领域广阔、高成品率、特殊器件不可替代等特性。从市场需求看,分立器件受益于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G通信射频等市场的发展,具有较大的发展前景;从分立器件原材料看,随着氮化镓和碳化硅等第三代半导体材料的应用,半导体分立器件市场逐步向高端应用市场推进。随着我国分立器件企业产品技术的不断提升,国内的终端应用客户也更加趋向于实施国产化采购,给国内半导体分立器件企业带来更多的发展机遇。

芯查查企业SaaS《2024年12月及2024全年元器件供应链监测和风险预警报告》表明,分立器件的价格指数全年走跌,除2024年3月小幅回涨外,近12月内分立器件价格指数一直在基准线下波动,价格低于2022年同期。总体来看,分立器件价格保持平稳,没有强劲终端需求,预计2025年分立器件价格指数继续保持低水位。分立器件交期指数全年逐步缩短,货品流通速度快,远低于基准线。消费电子行情有改善但动力不足,对于二极管、三极管、晶体管、IGBT等需求不热。

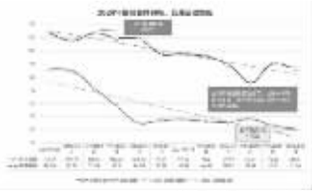


数据来源:芯查查企业SaaS(XCC.COM)

④集成电路行业概况

集成电路是信息处理和计算的基础,在科技革命和产业变革中发挥着关键作用。集成电路行业处于电子产业链的上游,其发展速度与全球经济增速正相关,呈现出周期性的波动趋势。从国家统计局和海关总署公布的相关数据来看,2024年我国的集成电路出口保持了良好态势。其中,根据国家统计局公布的数据显示,2024年我国集成电路产量为4,514.2亿块,同比增长22.2%。其中累计出口数量为2,981亿个,同比增长11.6%;累计出口金额为11,352亿元,同比增长18.7%。

芯查查企业SaaS《2024年12月及2024全年元器件供应链监测和风险预警报告》表明,模拟器件的价格指数全年大幅走跌,2024年上半年模拟市场景气度高,从6月开始,模拟器件跌至基准线以下,价格仍处于低位。国外模拟大厂如TI、ADI、ST等Q3模拟营收同比下降,从TI的3.9%到ST26.6%,工业和汽车市场是导致业绩大幅下降的主力军。模拟器件12月交期指数为41.06,下跌至2024年最低点,库存持续下调,交期持续加快,终端客户去库存乏力。



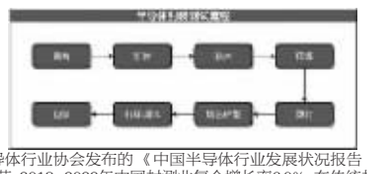
数据来源:芯查查企业SaaS(XCC.COM)

根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体行业发展状况报告(2024年版)》显示,预计2024-2026年,在集成电路产业周期性回暖,下游应用领域需求持续增长等多重因素影响下,中国集成电路市场规模增速将逐年提升,到2026年市场需求将达到22,935亿元。

⑤半导体封测行业概况

公司从事半导体封装测试业务,为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品;产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS等分立器件产品和LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、充电管理IC及LED驱动IC等集成电路产品。

封装环节是半导体封装和测试过程的主要环节。其功能主要包括两方面:首要功能是电学互联,通过金属Pin赋予芯片电学互联特性,便于后续连接到PCB板上实现系统电路功能;另一功能是芯片保护,主要是对脆弱的裸片进行热扩散保护以及机械、电磁静电保护等。



根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体行业发展状况报告(2024年版)》显示,封装和测试环节,2018-2023年中国封测业复合增长率6.0%。在传统封装向先进封装的转型的背景下,2023年国内集成电路封测业规模呈现小幅回调,产业规模2,932.2亿元,同比下降2.1%。但在先进封装的需求持续上升,国内晶圆级封装、2.5D/3D封装市场不断增长,企业重点布局产业创新和先进封装技术。

根据《2021-2025年中国半导体封测行业市场现状与发展前景报告》,预计中国半导体封测市场规模将从2021年的约3,467亿元增长至2025年的约5,189亿元,年复合增长率约为7%。在增速方面,随着国内半导体产业的快速发展及全球产能转移持续的趋势,中国半导体封测市场将继续保持较高的增长速度。

⑥公司市场地位

公司是国内半导体器件专业研发制造商,依托强大的自主技术研发能力和丰富的客户资源,经过多年深入研发和市场拓展,已成为国内多家知名企业的核心供应商之一,同时公司也是华南地区半导体器件主要的生产基地之一。

2.2、报告期内公司从事的主要业务

(1)公司主营业务

公司主要从事半导体封装测试业务,为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS等分立器件产品和LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、充电管理IC及LED驱动IC等集成电路产品。

半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展,在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下,附加值高的封装技术将得到越来越多的应用,封装测试业市场有望持续向好。封装测试行业的创新主要体现为产品工艺上的创新,技术水平主要体现为产品生产的工艺水平。公司一直以来注重封装测试技术的研发升级,通过工艺改进和技术升级构筑市场竞争优势,掌握金属基板封装、全集成锂电保护IC、功率器件封装、超薄芯片封装、半导体/IC测试、高可靠焊接、高密度框架封装、系统级封装(SIP)、倒装技术(FC)等一系列核心技术,在封装测试领域具有较强的竞争优势。

公司目前已通过自主创新,在封测全流程中成功构建了数字化、智能化、自动化生产体系,通过智能系统与辅助系统的协同工作,已基本实现了从客户订单接收到整个产品生产的智能互联。公司具备了覆盖从4英寸到12英寸晶圆全流程的封测能力,并在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体、车规级功率器件封装等领域实现了科技成果与产业的深度融合。

作为一家国家级高新技术企业,公司长期以来都以技术创新作为核心驱动力,依托多年深厚的行业经验与自主研发实力,我们始终遵循"以客户需求为中心"的服务宗旨,获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累,公司客户群体遍布华南、华东、西北、西南等多个地区,产品广泛应用于家用电器、电源、电声等多个领域,并致力于深度挖掘高净值客户资源。多年来,公司与客户建立了长期而稳固的合作关系。

公司以广东省省级企业技术中心和工程技术研究开发中心,持续投入半导体封测技术的研发及创新;随着公司募投项目建设的推进,公司在新建的厂房大楼中布局了研发中心的建设,新的研发中心建设项目引入了先进的研发和检测设备,优化了研发环境,整合了现有的研发资源;同时,通过吸纳高端技术人才,旨在缩短新产品和新技术的研发周期,进一步增强公司的研发实力和科技创新能力,为公司的发展提供坚实的基础。

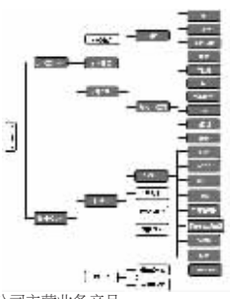
公司已荣获高新技术企业、国家知识产权优势企业等资质及荣誉。公司曾多次荣获广东省科学技术奖、佛山市科学技术奖等省、市科技奖项。报告期内,公司荣获广东省电子信息行业协会颁发的标杆企业称号,以及佛山市人民政府颁发的佛山市政府质量奖及佛山市科技领军企业(创新实力)两大殊荣。

截至报告期末,公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系标准认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证及ESD S20.20静电防护体系标准认证。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(2)公司的主要产品和服务

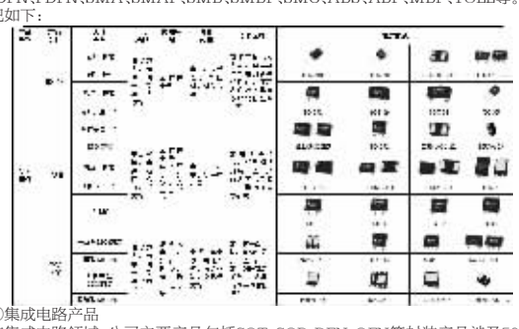
公司主要为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品,产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS等分立器件产品和LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理IC及LED驱动IC等集成电路产品。公司主营业务产品如下:



注:图中标蓝的产品为公司主营业务产品

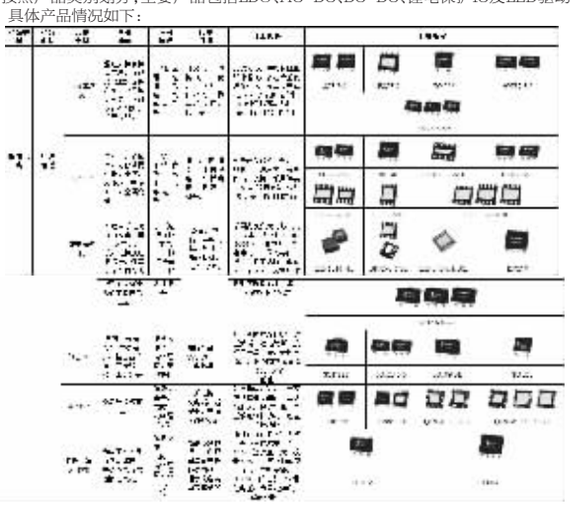
①分立器件产品

公司分立器件产品涉及50多个封装系列。按照功率划分,公司分立器件产品包括功率二极管、功率三极管、功率MOS等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品;按照具体产品类别划分,公司分立器件产品包括开关二极管、稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、ESD保护二极管、瞬态抑制二极管、数字三极管、小信号三极管、功率三极管、平面型MOSFET、沟槽型MOSFET、屏蔽栅型MOSFET、超结型MOSFET等产品;按照封装类型划分,公司分立器件产品主要封装形式包括TO、SOT、SOP、DFN、PDFN、SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC、ABS、ABF、MBF、TOLL等。具体产品情况如下:



②集成电路产品

在集成电路领域,公司主要产品包括SOT、SOP、DFN、QFN等封装产品涉及50多个系列,按照产品类别划分,主要产品包括LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护IC及LED驱动IC等。具体产品情况如下:



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,874,396,635.95	1,917,266,563.60	-2.24%	1,121,237,686.95
归属于上市公司股东的净资产	1,526,702,465.97	1,567,590,701.60	-2.61%	725,216,318.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	713,059,932.31	736,580,879.68	-3.19%	751,633,605.95
归属于上市公司股东的净利润	15,111,764.37	58,368,765.24	-74.11%	71,424,649.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,892,252.47	42,396,530.89	-74.31%	69,168,448.44
经营活动产生的现金流量净额	139,038,717.12	92,607,221.44	50.14%	95,995,329.83
基本每股收益(元/股)	0.08	0.35	-77.14%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.35	-77.14%	0.48
加权平均净资产收益率	0.98%	5.75%	-4.77%	9.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,776,393.01	185,234,603.78	182,031,978.48	208,016,957.04
归属于上市公司股东的净利润	-8,305,957.50	468,790.65	7,931,376.44	15,017,554.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,214,789.00	266,455.51	5,719,640.98	14,120,944.98
经营活动产生的现金流量净额	10,014,641.71	17,392,372.39	28,763,931.66	82,867,771.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,150	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王成名	境内自然人	15.83%	31,669,430.00	31,669,430.00	不适用	0.00
陈湛伦	境内自然人	9.86%	19,716,218.00	19,716,218.00	不适用	0.00
上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.71%	17,411,104.00	0.00	不适用	0.00
张顺	境内自然人	7.55%	15,107,565.00	15,107,565.00	不适用	0.00
舒程	境内自然人	3.27%	6,538,902.00	0.00	不适用	0.00
广东比邻投资基金管理有限公司-比邻创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.04%	6,082,902.00	0.00	不适用	0.00
赵秀珍	境内自然人	0.98%	1,958,549.00	1,468,912.00	不适用	0.00
曾周浩	境内自然人	0.82%	1,643,850.00	0.00	不适用	0.00
袁凤江	境内自然人	0.78%	1,565,648.00	1,166,736.00	不适用	0.00
陈鹏	境内自然人	0.54%	1,076,853.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王成名、陈湛伦、张顺为一致行动人。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

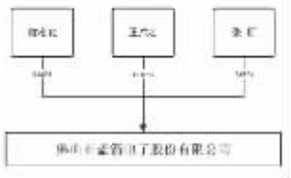
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)权益分派顺利完成

为保持股东回报水平的长期、稳定,公司综合考虑了中长期发展规划和短期生产经营的实际情况,在保障公司现金流的稳定性和长远发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,公司2023年年度权益分派方案已实施完毕。公司以截至2023年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),共计派发现金红利总额为人民币56,000,000元(含税)。具体内容详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号2024-036)。

(二)对外投资

公司于2024年9月30日和2024年11月26日,分别对外参股出资设立佛山市星通半导体有限公司和广东兴睿微电子有限公司。其中,佛山市星通半导体有限公司注册资本7,000万元人民币,公司持股比例为49%;广东兴睿微电子有限公司,注册资本8,000万元人民币,公司持股比例为35%。以上事项已完成工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交董事会和股东大会审批。

证券代码:301199 证券简称:迈赫股份 公告编号:2025-017

迈赫机器人自动化股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以133,340,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	迈赫股份	股票代码	301199
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢中庆	王海兰	
办公地址	山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号	山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号	
传真	0536-6431139	0536-6431139	
电话	0536-6431139	0536-6431139	
电子信箱	mhauto@mhauto.cn	mhauto@mhauto.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)行业发展概况

按照行业分类,公司处于国家重点支持的智能装备制造业领域,智能装备制造业是高端装备制造业的核心领域,集成了人工智能、物联网、大数据等前沿信息技术,促进了制造业向自动化、数字化、智能化的转型。公司具体业务主要围绕智能制造系统整体解决方案展开布局,涵盖高端智能装备系统、智慧物联系统、规划设计业务,专业从事基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统和智慧物联系统的研发设计、制造集成、销售和智慧运维等服务。

1)智能制造行业的发展阶段

在国家政策、市场需求、数字技术等因素的共同推动下,全球智能制造装备产业快速发展,尽管自2022年起,受疫情影响以及全球经济增速减缓的双重作用,智能制造装备产业的增长速度亦呈现出逐渐减缓的趋势,但仍呈正比例增长的态势。据Statista数据,2023年全球智能制造装备产业市场规模为1.72万亿美元,增速为1%左右。当前,以AI为首的新一代信息技术的持续突破持续推动全球制造装备的智能化升级,从而使得全球智能制造装备产业需求继续保持增长。

智能制造装备是制造业发展的重要基础产业,其安全和自主可控关乎着我国制造业的安全和健康发展。我国制造业的高端化转型以及国家安全自主需求必将推动我国智能制造装备产业的蓬勃发展,根据《2025年国务院政府工作报告》的数据,2024年度,高技术制造业和装备制造业的增加值将分别实现8.9%和7.7%的增长。

根据联想集团有限公司发布的《中国企业智能化成熟度报告(2024)》,2024年企业智能化转型步伐开始出现分化,领先企业正在加速迈进创新发展新阶段,为行业变革注入新动力。达到创新发展水平(L5)的企业比例同比提升5个百分点,达到6%。不过,整体而言,智能化的发展空间有待进一步开拓,仍有78%的企业处于L1~L3的早中期。

不同智能化成熟度水平的企业占比

数据来源:联想集团《中国企业智能化成熟度报告(2024)》

2)智能制造行业的技术驱动与创新

智能制造行业的技术驱动与创新是推动制造业向高效、柔性、绿色方向升级的核心动力。在当前技术飞速发展的背景下,智能制造行业正经历一场深刻的技术驱动与创新变革。云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术的有机结合,为智能制造提供了坚实的技术基础。云计算平台凭借其高效的资源调度和灵活的计算能力,助力制造企业实现数据的集中存储、高效处理和深度分析,推动生产过程的智能化转型。大数据技术则通过挖掘海量数据中的潜在价值,助力企业优化生产策略、提升运营效能。物联网技术的广泛应用,使得生产设备、产品及人员之间的互联互通成为现实,构建起一个高度智能化的生产生态系统。人工智能技术在智能制造领域的应用日益广泛,其应用使得智能系统能够实现智能决策与控制。

随着市场竞争的日益激烈,众多企业纷纷加大研发投入,推动技术创新和产品升级。它们通过引进先进的研发设备和人才,不断提升自身的核心竞争力,以应对日益激烈的市场竞争。这些企业在技术创新方面不断探索,致力于开发出更加高效、环保、智能的产品,以满足市场的多样化需求。

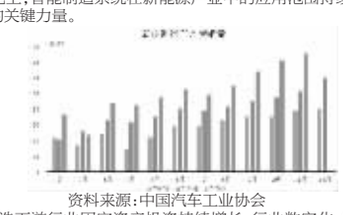
同时,产学研合作也成为推动智能制造技术创新的重要途径。高校、科研机构与企业之间的深度合作,加速了科技成果的转化和应用,推动了智能制造技术的快速发展。政府政策的支持和引导也为智能制造行业的技术创新提供了有力保障。通过制定相关政策和规划,政府为智能制造行业的发展指明了方向,提供了资金、税收等方面的优惠政策,激发了企业的创新活力。

此外,智能制造业也在积极推动与其他行业的深度融合。通过智能化技术的应用,智能制造业正在改变传统制造业的生产模式,提高生产效率和产品质量,这种跨行业的合作模式为经济的持续增长注入了新的活力,推动了整个社会的创新发展。

3)智能制造行业的市场需求与增长动力

智能制造下游应用场景丰富,涵盖了纺织、造纸、新能源产业、通用/专用设备制造、电气机械和器材制造等多个行业,为工业智能化生产管理提供数控机床、成套设备等智能制造装备,基于数字化车间/智能工厂设计、产品研发及工艺设计、生产作业、仓储配送、设备运维、安全管控、能源与环保、经营管理等应用场景提供智能制造系统解决方案。

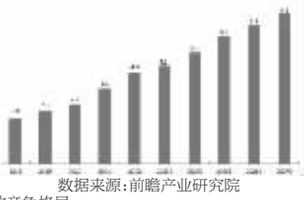
近年来,新能源产业迎来了爆发式的增长,特别是在新能源汽车领域的生产线建设中,智能制造系统解决方案的需求显著增加。2024年,新能源汽车年产量突破1300万辆。这些生产线对智能制造系统的需求不仅集中在生产线自动化和智能化改造上,还扩展到了对生产全流程的深度优化上,智能制造系统在新能源产业中的应用范围持续扩大,将成为推动智能制造行业发展的关键力量。



资料来源:中国汽车工业协会

近些年,智能制造下游行业固定资产投资持续增长,行业数字化、智能化水平不断提升,支撑我国智能制造万亿市场规模,2023年,我国智能制造行业市场规模(包括智能制造装备及智能制造系统解决方案)为4.3万亿元,预测到2027年,我国智能制造行业市场规模将达到6.6万亿元,其中智能制造装备市场规模约5.4万亿元,智能制造系统解决方案市场规模约1.2万亿元。

2018年-2027年中国智能制造行业市场规模及前景预测(万亿元)



数据来源:前瞻产业研究院

4)智能制造行业的竞争格局

目前,智能制造行业的竞争格局正在逐渐形成。国内外众多企业纷纷布局智能制造领域,通过技术创新和市场拓展,不断提升自身的竞争力。在国际市场上,德国、美国、日本等发达国家在智能制造领域处于领先地位,拥有众多世界知名的智能制造企业和先进的技术产品。这些企业凭借其在自动化、信息化、智能化等方面的优势,占据了全球智能制造市场的大部分份额。

从五力竞争模型角度分析,目前我国智能制造行业企业数量较多,但具有较强品牌优势的企业数量相对较少,且智能制造企业提供的产品具有一定的差异性,竞争压力较大;上游产品供应数量较多,但由于国内智能制造行业整体技术水平落后国外先进企业,部分关键零配件被少数国外企业控制,国内市场依赖进口,使得上游供应企业对智能制造行业议价能力较强;下游和中游链接紧密,智能制造市场需求旺盛,消费者议价能力一般;智能制造是未来制造业转型的重要发展方向,目前尚不存在替代品,替代品威胁较弱;新进入者方面,由于目前我国制造业智能化转型的大趋势已成,且有国家政策的大力扶持,新进入者的威胁较大。

未来,随着智能制造技术的不断发展和应用领域的不断拓展,智能制造行业的竞争格局将会更加复杂多变。

(2)公司主要业务、产品及其用途

公司是一家专注于为用户提供高端智能装备系统、智慧物联系统的高新技术企业,专业从事基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统和智慧物联系统的研发设计、制造集成、销售和智慧运维等服务。公司下设全资子公司迈赫设计院及迈赫优沃。其中,迈赫设计院主要从事规划设计业务,迈赫优沃辅助公司开展智慧物联系统相关业务。

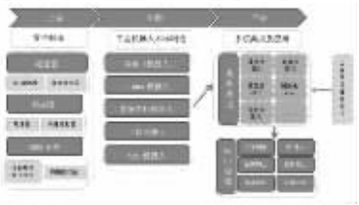
公司所从事的具体工作是一个完整的"技术+产品+服务"的过程,利用数字化、信息化技术赋能传统制造业的转型升级,从而为客户提供智能制造与智慧物联系统整体解决方案,是先进制造技术与信息技术、数字化技术的高度集成。其次,公司也十分注重规划设计业务的发展,早在2011年就设立了全资子公司迈赫设计院,打通了上游设计业务与下游智能制造环节,形成了更为完整的智能制造一体化产业链。

公司主要产品是智能装备系统及动力能源供应系统、规划设计业务。其中公司智能装备系统及动力能源供应系统产品包含智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统以及公用动力及装备能源供应系统。产品及服务主要应用于汽车、工程机械及其零部件等行业领域。由公司全资子公司迈赫设计院开展的规划设计业务,主要服务内容包括工业工艺规划设计和建筑设计等。迈赫设计院具备机械行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、城乡规划乙级等设计资质,能够为建筑、机械、军工、农业、物流等行业领域提供可行性分析、总体规划、总图及物流规划、方案设计、施工图设计及建设工程(EPC)总承包业务的技术与管理服务。

(3)公司产品的市场地位、竞争优势与劣势

1)公司产品的市场地位

公司产品主要应用于汽车智能装备制造领域,所处的细分行业为智能制造项下的智能制造系统解决方案范畴,公司产品在工业机器人产业链中所处的环节具体详见下图:



公司不但同时涉足智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统等三大类智能装备系统的设计、制造、安装及集成,并在各自细分市场收获了一定的行业知名度。还通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业设计服务、建筑设计服务,形成了更为完整的智能制造一体化产业链。此外,公司利用自身多年在智能装备系统集成领域积累的技术和项目经验,通过物联网、大数据等先进技术的应用,为精准掌握市场需求、生产出更加符合客户要求的产品提供了智能化支持,为成为高端智能装备系统与智慧物联系统整体解决方案服务商打造了坚实的基础。

现代、高效、专业的经营管理体系保证了公司在同行业中拥有强大的竞争优势,公司始终坚持技术创新,增强创新能力,在坚持技术创新的基础上推动产品创新,并把技术攻关计划与科技成果产业化紧密结合起来,保证了公司主要产品的行业领先地位。

2)竞争优势

近年来随着公司产品线不断增加,公司核心竞争力与行业地位持续提升。同时,凭借产品质量优势、高端人才储备优势、技术研发优势、管理优势及整体解决方案服务优势等,快速响应客户需求,促成更具智慧的商业对话,加速销售增长。

①产品质量优势

公司始终将产品质量视为企业的生命线,严格把控从原材料采购至产品交付的每一个环节。凭借贯穿产品设计研发、材料采购、生产安装、验收检验等全过程的质量控制,公司已通过了严格的质量体系认证,并获得了客户的普遍认可。此外,公司还建立了完善的售后服务体系,能够迅速响应客户反馈,及时提供技术支持与解决方案,进一步增强了客户对产品的信任与满意度。自公司成立之初,即专注于产品质量,致力于集中资源把产品做好,十年如一日,为公司赢得了良好的口碑和更强的生命力。

②高端人才储备优势

技术人才是智能装备制造行业的核心竞争力,公司始终重视人才"引、育、留"工作。截至2024年12月31日,公司拥有设计技术人员438人,硕士及硕士以上学历32人,本科学历410人。为了更精准的招引高精尖人才,公司在上海成立了分公司,在济南设立了全资子公司迈赫优沃,在天津设立了全资子公司迈赫设计院,并分别在济南、青岛、潍坊、无锡设立了分院。另外,为了最大限度的吸引、留住人才,公司还分别在济南市及潍坊市建立了研发中心,充分有效地利用了场地、人员、公共基础设施等各方面的优势,增强了公司高端人才的储备。同时,公司也积极组织技术人员培训、开展智能制造及机器人领域相关的课题研究、学习国外先进技术并消化利用、挖掘下游客户个性化需求等方式培育人才,以保证技术人员更好的学习到行业前沿技术。此外,公司不但为人才提供了饮食、住宿、交通、娱乐等方面的便利条件还利用员工持股平台使人才和公司发展直接挂钩,这种大利益观的人才发展体制为公司留住人才奠定了坚实的基础。

③技术研发优势

研发是现代企业持续发展、构筑竞争实力的核心。公司自成立以来,在技术研发方面持续投入,通过自主研发、积累,形成了坚实的核心技术实力。公司作为高新技术企业,先后荣获了国家博士后科研工作站、国家智能制造系统整体解决方案供应商、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家级专精特新"小巨人"企业、山东省优秀企业、山东省工业机器人实验室、山东省智能制造"1+N"标杆企业、山东省"专精特新"中小企业、山东省单项冠军企业、山东省工业互联网标杆企业、山东省企业技术中心、山东省技术创新示范企业、山东百年品牌重点培育企业、山东省高端装备制造业领军(培育)企业、省级工业设计中心、山东省"一企一技术"研发中心等多项荣誉。2024年,公司的"黑灯工厂之汽车智能焊装主线"产品荣获山东省第五届"省长杯"工业设计大赛金奖,"全方位重载多功能激光导航自动移动AGV项目"荣获潍坊市科技进步奖二等奖。截至2024年12月31日,公司拥有发明专利51项、实用新型专利146项、外观专利7项、软件著作权44项。经过多年的持续努力,公司构建了一套自主创新体系,在行业展现出了较强的竞争力。

公司设有专业的研发团队,不断攻克技术难关,在保证现有产品质量稳中有升的前提下,持续加大研发创新。公司2024年度的研发投入为4,941.54万元,2024年新增研发项目:多车型快速切换的焊装新型输送系统;新能源汽车制造智能控制系统研发项目;物联网边缘侧数据集成及处理系统研发项目等,较好地完成了年度新产品和新技术的研发任务。持续的研发创新为公司发展提供了强有力的支撑,提升了公司的市场竞争力,从而为公司的进一步发展创造了有利条件。

公司不断在新型车身连接工艺、智能化装配技术等方面进行研发投入,保持持续的行业先进水平;在能源优化、高柔性调度等方面进行不断创新,促进节能减排与效率提升;在人工智能、数字孪生等新技术上不断探索,推动公司产品智能化升级。

2023年,公司根据市场预判与自身经营情况,开启了优沃工业互联研发升级扩建项目的建设。以创新为动力,以技术突破为手段,以客户体验为导向,致力于构建企业与客户共享的价值体系。通过打通产业链各环节的数据孤岛,实现数据的传递、共享和应用,从而为企业发展提供智能化支持。

自2024年以来,优沃工业互联研发升级扩建项目部分项目开发执行人员陆续到位,先后投入到软件前后端、嵌入式、产品设计等领域的开发工作中。构建了统一认证中心,实现了多端单点登录与权限管控体系,客户侧提供了企业认证、团队协作、产品订阅及客户支持等服务,管理端实现了用户管理、产品发布、数据看板等后台管控功能。

④管理优势

近几年,公司持续推进落实管理团队"年轻化"的战略部署,强化战略定力与发展韧性,激活内生动力,促进公司持续稳定发展。提升管理团队年轻人才比例,不仅有利于公司团队结构优化,促进培育和建设专业化、年轻化的人才梯队,同时在日趋激烈的市场竞争环境下,也有利于公司的健康、高速发展,公司因此具备较强的管理优势。

公司注重管理团队的培训与提升,定期组织专业技能和管理能力的培训,确保管理团队具备前瞻性的战略眼光和高效的管理能力。此外,公司还建立了完善的管理制度和流程,确保各项决策能够迅速、准确地得到执行,提高了整体运营效率。通过不断优化管理流程,公司实现了资源的合理配置和高效利用,进一步巩固了管理优势。

⑤整体解决方案服务优势

公司同时涉足智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统等三大类智能装备系统的设计、制造、安装及集成,不仅能够提供单一装备系统的解决方案,还能根据客户的实际生产需求,提供包括智能焊装、智能涂装、智能总装在内的全方位一体化服务。这种全面的服务模式,有效提升了客户的生产效率,显著降低了运营成本,并大幅增强了客户的市场竞争能力。

公司所提供的整体解决方案服务,不仅涵盖了智能装备系统的设计、制造、安装与集成,还深入到了工业设计、建筑设计的上游环节,这种端到端的服务模式,极大地提升了项目执行的效率和质量。通过迈赫设计院平台,公司能够快速响应客户的多样化需求,从源头上保障项目的创新性和实用性。

在智能制造一体化产业